

公司代码：688206

公司简称：概伦电子

上海概伦电子股份有限公司  
2024 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅公司 2024 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”的相关内容。

3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

☐是 ☒否

### 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润，利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本 433,931,345 股，扣除回购专用账户1,300,070 股，可参与利润分配股数 432,631,275股，以此合计拟派发现金红利12,978,938.25元（含税）。2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

同时，根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,007,759.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用），综上，现金分红和回购金额合计32,986,697.35元。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 |            |      |        |         |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所科创板 | 概伦电子 | 688206 | 不适用     |

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                              | 证券事务代表 |
|------|------------------------------------|--------|
| 姓名   | 郑芳宏                                | /      |
| 联系地址 | 中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号、秋月路26号4幢901室 | /      |
| 电话   | 021-61640095                       | /      |
| 传真   | 021-61640095                       | /      |
| 电子信箱 | IR@primarius-tech.com              | /      |

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的 EDA 全流程解决方案，主要产品及服务包括制造类 EDA、设计类 EDA、半导体器件特性测试系统和技术开发解决方案等。

公司通过各类 EDA 产品线,帮助晶圆厂在工艺开发阶段评估优化工艺平台的可靠性和良率等特性，设计和优化半导体器件参数和工艺流程，提供半导体器件测试系统完成晶圆级的各类半导体器件特性测试，基于测试的器件特性数据建立精确的器件模型、PDK 和标准单元库，并通过可拓展的全定制电路设计环境和快速精准的电路仿真，为不同的集成电路设计应用提供各种应用驱动的全流程 EDA 解决方案，支持全定制存储器设计和模拟/混合信号电路设计，同时支持 SoC 芯片设计、规划与验证、时序验证和标准单元库特征化与验证。在此基础上，根据行业特点和应用需求以 DTCO 为核心驱动力，逐步建立针对工艺开发和制造的制造类 EDA 全流程解决方案，推

出针对高端存储器设计的 EDA 全流程，不断完善及提升模拟电路设计类全流程解决方案，全力打造数字电路设计类全流程解决方案，并通过现有领先的测试仪器产品与 EDA 软件形成软硬件协同，向客户提供差异化和更高价值的数据驱动的 EDA 全流程解决方案。

## 1. 制造类 EDA

立足于行业领先的器件建模核心技术和先进方法学，公司制造类 EDA 产品线历经十余年不断迭代和创新，涵盖从 SPICE 模型、PDK 套件到标准单元库开发各阶段的十多款 EDA 产品，形成了业界领先的设计实现（Design Enablement）EDA 综合解决方案。针对一个典型工艺平台的完整的 Design Enablement 流程开发周期通常长达数月之久，是加快 DTCO 流程效率的瓶颈，公司通过将自动化、并行加速、云计算等先进方法学与 EDA 产品技术相结合，帮助客户显著提高生产效率，可以在需要快速的工艺开发迭代时将周期从数月缩短至数周，助力芯片制造与设计更高效地协同优化，提升芯片产品 YPPA（指芯片 Yield 良率、Performance 性能、Power 功耗、Area 尺寸四大核心指标）。

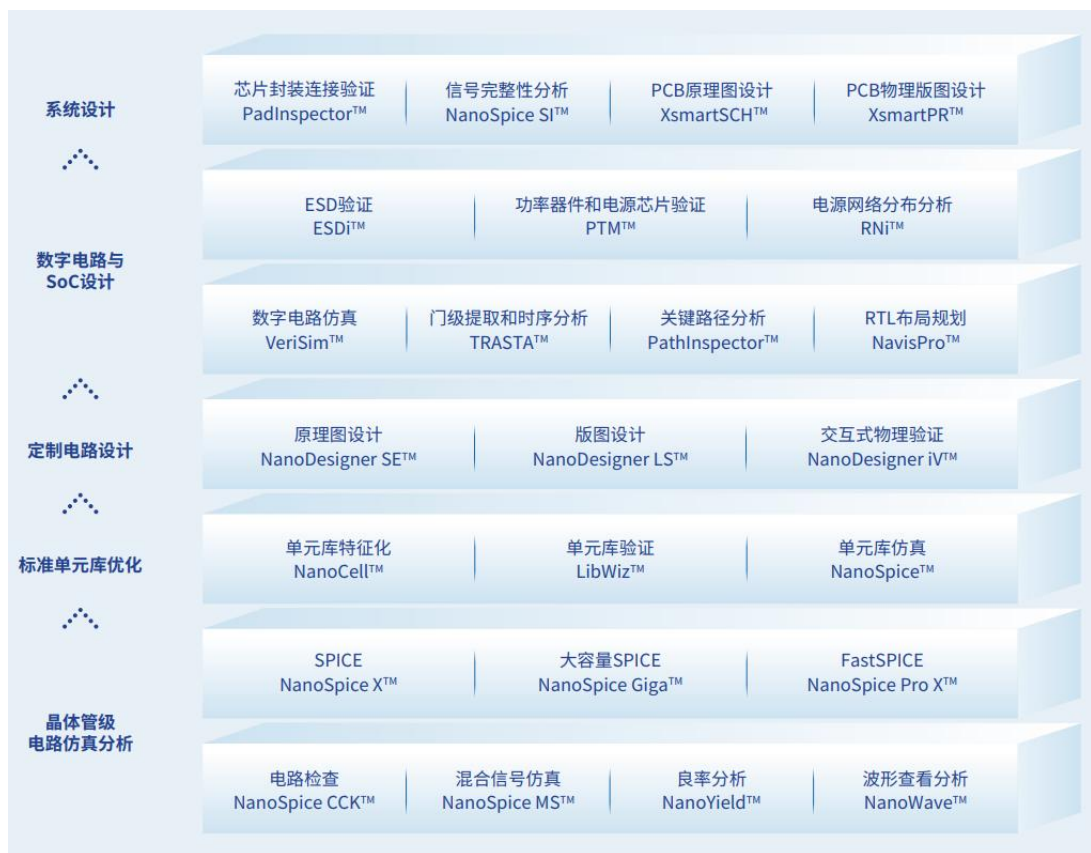


## 2. 设计类 EDA

以 DTCO 理念构建应用驱动 EDA 全流程，公司设计类 EDA 基于行业领先的电路仿真核心技术，产品涵盖了模拟、存储、射频、化合物、面板等领域的全定制电路设计，并积极扩展数字电路和 SoC 设计流程的应用领域。NanoSpice™系列是全球领先的电路仿真解决方案之一，SPICE 和 FastSPICE 产品凭借卓越性能为客户提供最全面的电路分析、验证和优化，满足各类应用需求，已被国内外众多领先设计公司大规模采用。此外，与 VeriSim™数字仿真器无缝结合，实现高效的混合信号仿真验证。全定制电路设计平台 NanoDesigner™具备出色的电路设计工具集，包括原理

图与版图设计功能，还附带有众多电路设计分析和优化功能，可显著缩短从模块级到芯片级设计的周期，从而提升设计效率，加速产品的上市时间。

公司设计类 EDA 产品线包括电路仿真分析、标准单元库优化、定制电路设计和数字电路与 SoC 设计。通过深入了解客户需求和市场趋势,不断提升现有产品的性能和功能，提高整体效率和可靠性，同时致力于新产品研发和发布,以填补市场空白、拓展产品线,满足不断涌现的新需求。该类产品全面覆盖存储器、人工智能、高性能计算和汽车电子等领域，广泛应用于设计公司全定制电路设计、SoC 芯片开发，IDM 与晶圆厂设计流程搭建,和科研院所芯片设计研发，为客户提供领先的芯片设计 EDA 解决方案。

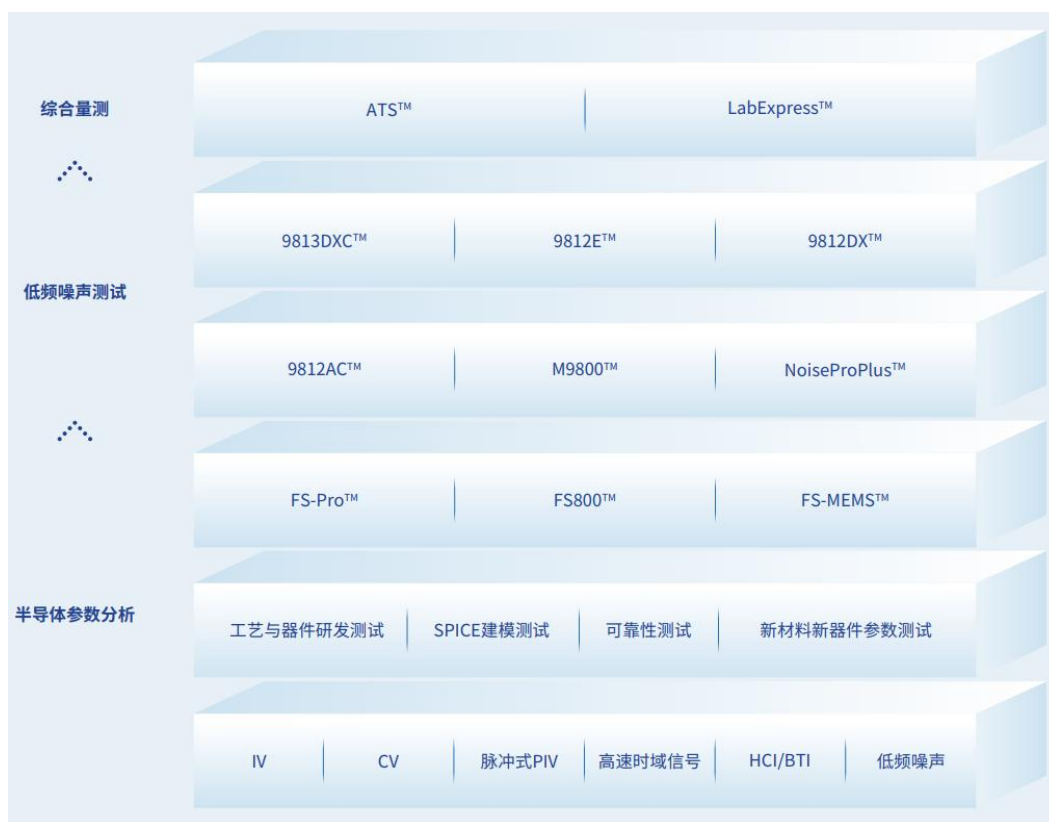


### 3. 半导体器件特性测试系统

公司电特性测试系统以卓越的性能和稳定的质量，与 EDA 产品软硬件协同，全面覆盖半导体器件电学特性测试、噪声特性测试、晶圆级电学参数测试和可靠性测试等领域，广泛应用于 IDM 与晶圆厂工艺平台研发，芯片设计公司 COT 流程开发和定制，和新材料、新器件及工艺研发，实现从科研到量产全覆盖。

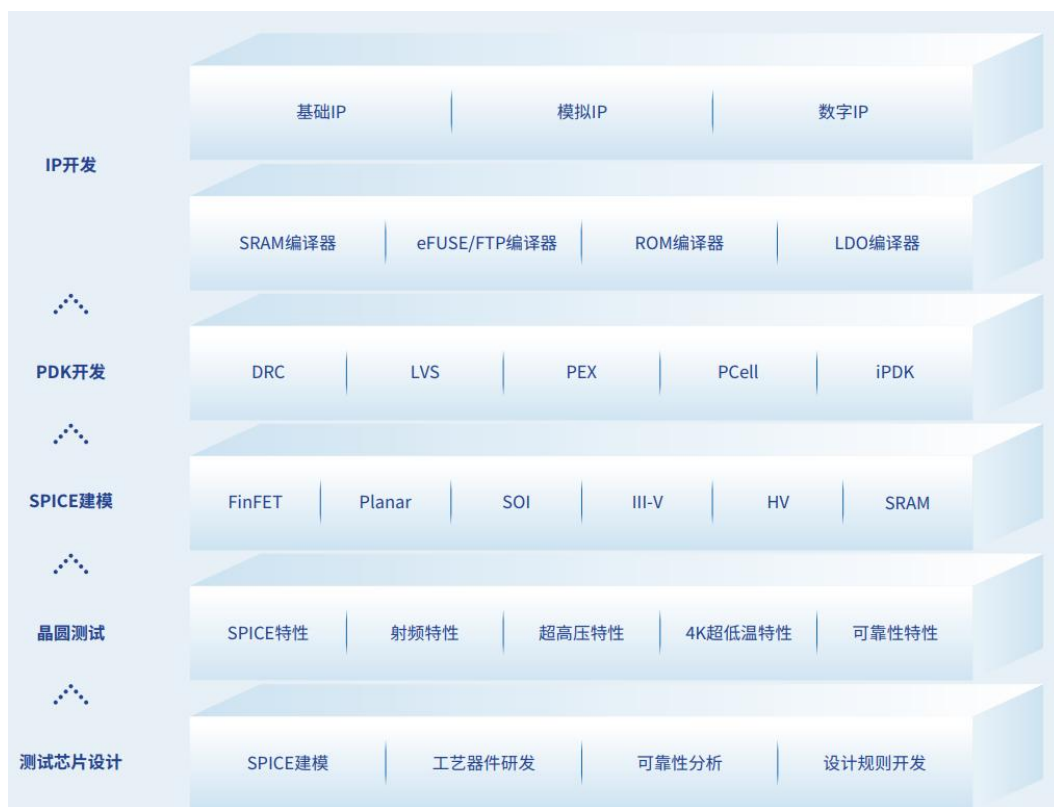
基于行业领先的核心技术，公司 981X 系列低频噪声测试系统黄金工具已获得业界头部企业的普遍认可和应用，同时不断推进产品迭代和新品研发，为客户提供差异化和具有更高价值的数

据驱动解决方案。



#### 4. 技术开发解决方案

概伦电子致力于打造业界领先的半导体技术开发平台，以业界领先的晶圆测试实验室和超大规模的 EDA 计算中心为依托，结合自有 EDA 全流程产品和先进的测试解决方案，以及十余年服务全球领先设计和制造企业积累的丰富经验和技術能力，为客户提供专业的一站式技术开发解决方案，在测试/建模/PDK/IP 等传统工程服务基础上，通过 DTCO 赋能晶圆厂的工艺平台研发和芯片设计的竞争力提升，以高附加值的 EDA 流程定制和 COT 平台建设推动公司 EDA 产品的验证和导入。目前可支持工艺节点从 0.35 微米到 5 纳米的 CMOS 平面及 FinFET 工艺、Bi-CMOS、RFSOI、FDSOI、BCD、化合物半导体到 CNFET、FPD 的各类半导体工艺平台，广泛应用于数字逻辑芯片、模拟芯片、射频芯片、显示驱动芯片、存储芯片、超高压芯片、超导量子芯片、超低温 MOS 芯片等的工艺研发和电路设计。



## 2.2 主要经营模式

公司的主要经营模式具体如下：

### 1. 盈利模式

公司主要盈利模式包括：

(1) 向客户授权 EDA 工具而获得软件授权相关收入。EDA 软件授权业务分为固定期限授权和永久期限授权，公司的 EDA 软件授权业务以固定期限授权业务为主，且多为三年期限授权。

公司对于固定期限授权的 EDA 工具，公司在授权期内持续对售出软件进行版本升级，并向客户提供技术咨询。对于固定期限授权业务，公司在授权期内按照直线法确认收入。

对于永久授权的 EDA 工具，公司向客户提供售出版本软件的永久使用权，并提供一定期间内的版本升级、技术咨询等后续服务，客户可在服务期满后单独购买后续服务。对于软件永久使用权销售以时点法确认收入，对于期间内的版本升级和技术咨询等服务在约定的服务期限内按照直线法确认收入。

(2) 向客户销售半导体器件特性测试系统而获得产品销售收入。

(3) 向客户提供技术开发解决方案而获得收入。

### 2. 采购模式

公司采购的主要内容为网络基础设施（如网络带宽、服务器等）和各类硬件模块及相关配件等。具体采购流程包括需求分析与技术评估、供应商选择与谈判、合同签订与执行、需求部门验收、供应商管理等。公司采购内容市场供应充足，供应商在具备可选性的同时保持相对稳定，能够满足公司的特定要求，采购渠道通畅。

### 3. 研发模式

公司研发团队根据市场和客户需求确定产品和技术研发方向，设定目标并开展研发工作，具体流程如下图：

### 4. 服务模式

#### （1）技术支持服务

公司设有专门的技术服务团队，在服务期内为客户提供技术支持服务，有效满足客户使用需求，具体模式如下：

对于固定期限授权的 EDA 工具，公司在授权期内持续对售出软件进行版本升级，并向客户提供技术咨询；对于永久授权的 EDA 工具，公司向客户提供售出版本软件的永久使用权，并提供一定期限内的版本升级、技术咨询等后续服务，客户可在服务期满后单独购买后续服务。

对于半导体器件特性测试系统，公司提供一定期限内的软件版本升级、技术咨询等后续服务。客户可在服务期满后单独购买后续服务。

#### （2）技术开发解决方案

公司的技术开发解决方案主要是利用自有的 EDA 工具和测试设备，基于自身为全球客户服务且多年积累的经验和能力，为客户提供测试结构设计、晶圆级测试、SPICE 建模、PDK 开发、标准单元库特性化及 IP 开发等一站式设计支持（Design Enablement）技术开发解决方案，并根据客户的应用提供相应的 EDA 工具、设计流程和增值的 EDA 解决方案。

目前，该项业务除了为客户提供基础的工程服务外，越来越多地附加了诸多新技术、新流程、新思维、新方法的开发，以及客户端 EDA 流程的建设和 EDA 产品的验证及导入，在交付基本的业务流程或业务结果外，为客户创造了额外的技术价值及技术成果。

### 5. 营销模式

公司目前采取以直销为主、经销为辅的销售模式，不断加强自身销售网络建设，积极通过展会、网络、行业媒体等渠道对公司及产品进行推广。对于北美、韩国、中国大陆等业务量较大的地区，公司主要采取直销模式，对于日本等地区主要采取经销模式。在面向大学及专业研究机构客户时，部分半导体器件特性测试系统的销售也会采取经销模式。



公司采取直销模式的地区多为客户资源多、市场需求大、业务基础较好的区域。该等区域内通常国际领先集成电路企业较为集中，为更好地服务客户，及时响应客户需求，公司通常配置本地化的销售和技术支持团队。基于投入产出比的考虑，公司在日本等地区，通过经销商的市场和销售渠道进行推广和销售。

## 6. 生产模式

公司硬件产品低频噪声测试仪器系列产品以及半导体参数测试仪器（FS-Pro、FS-MEMS）生产过程系通过对采购的标准化模块以及机箱组件进行简单装配并嵌入自主研发的软件产品并进行一系列功能检测、软硬件适配集成和调试校准。

公司硬件产品高精度源测量 SMU 和半导体参数测试系统 FS800 则采用协同式生产模式。通过直接采购标准化元器件等模块精准把控源头质量，借助其成熟工艺与规模优势确保品质与产能。相关机械部件则由公司自主设计，再交由供应商依据设计方案加工，实现设计与制造的高效衔接。所有加工完成的模块返回公司，凭借专业组装团队进行精细组装，在统一的质量管控体系下，将各部分整合为完整、高性能的 SMU 和 FS800 产品。

对于部分供货周期较长的供应商，公司通常根据销售预计情况提前安排采购，其余原材料在获取客户订单后开始安排采购，原材料齐备后通过简单装配并嵌入软件产品，并将其适配集成，调试至可使用状态。

## 7. 采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素和影响因素在报告期内的变化情况 及未来变化趋势

公司的主要收入来源于 EDA 软件授权，该等授权模式是国际 EDA 行业通行的经营模式。报告期内，公司经营模式及关键影响因素均未发生重大变化，在可预见的未来预计也不会发生重大变化。公司将围绕既定的战略布局，持续进行技术创新和积累，密切关注行业发展和变化，与客户和合作伙伴共同探讨行业新的技术趋势，不断对前沿技术进行探索和实践，并根据实际需要适当调整和优化现有经营模式。

## 2.3 所处行业情况

### (1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

EDA 行业作为集成电路产业的战略基础支柱，近年来在政策支持、市场需求和技术突破的多重驱动下，展现出快速发展的态势。同时，随着国产替代进程的加速，中国 EDA 行业在技术、人才、资金等方面的投入不断增加，为行业的长远发展奠定了坚实基础。总体而言，中国 EDA 行业正处于从“国产替代”向“技术引领”转型的关键时期，未来几年将在技术创新、市场拓展和生

态建设等方面取得更大突破。

### **(1) 整合并购是 EDA 行业快速发展的重要推动力**

整合并购是推动行业整合与技术升级的重要手段。我国 EDA 行业的并购活动主要集中在技术补强和市场拓展两个方面。一方面，国内领先企业通过并购获取关键技术和人才，加速在 AI、云化、Chiplet 等新兴技术领域的布局，快速补齐技术短板，完善产品线；另一方面，企业将通过并购加强与产业链上下游的合作，共同打造 EDA 生态。

从客户的角度来看，EDA 行业的整合并购对降低软件使用成本和提高设计效率具有显著的积极影响。近年来，随着全球 EDA 市场的竞争加剧以及技术的快速发展，企业通过并购实现技术整合和资源优化，为客户带来了实实在在的好处。首先，并购整合有助于降低软件使用成本。通过并购，EDA 企业能够实现技术互补，减少对单一工具的依赖，从而为客户提供更全面的解决方案。例如，新思科技通过并购 Ansys，不仅强化了自身在仿真领域的技术实力，还通过整合资源降低了客户的使用成本；新思科技推出的 FlexEDA 业务模型，允许客户通过云积分按需购买 EDA 工具，而非传统的许可证购买方式，这大大降低了客户的初始投资和运营成本。其次，并购整合显著提高了设计效率。并购后的 EDA 企业能够整合不同工具的优势，减少设计流程中的切换和兼容性问题，同时客户在使用过程中无需频繁切换不同软件，避免了因工具间兼容性问题导致的工作中断，从而显著提升了设计效率。未来，随着国产 EDA 企业的进一步崛起和技术创新，客户将享受到更多高效、低成本的设计工具和服务，我国国产 EDA 工具的市场渗透率将进一步提高。

### **(2) 中国 EDA 行业作为集成电路产业的核心支撑，目前存在着以下技术门槛：**

①核心算法与技术积累门槛：EDA 行业的核心竞争力在于复杂的核心算法和长期的技术积累。高端数字设计和 SoC 设计需要高度复杂的数学算法和优化方案，这些技术需要数十年的积累和持续创新。例如，在数字电路设计中，EDA 工具需要支持从逻辑综合到物理验证的全流程自动化，这对算法的精度和效率提出了极高要求。国内企业在这一领域的积累相对薄弱，难以迅速赶超国际巨头。

②工具集成与互操作性门槛：现代 EDA 工具不仅需要具备独立功能，还需要实现高度集成与互操作性。EDA 工具链涉及多个环节，包括电路设计、仿真验证、物理设计等，各模块之间需要无缝衔接。此外，EDA 工具还需要与不同制造工艺兼容，这对厂商的系统集成能力提出了巨大挑战。国际巨头凭借长期的市场主导地位和技术积累，在工具集成方面具有显著优势，而国内企业则需要在这一领域投入大量资源进行研发。

③工艺适配与先进制程支持门槛：EDA 工具必须根据不同的半导体工艺节点进行优化，以支

持从成熟工艺到先进制程（如 7nm、5nm）的设计需求。尤其是先进制程的设计，对 EDA 工具的精度和性能提出了更高要求。国内企业在工艺适配方面面临巨大挑战，尤其是在先进制程的支持上，与国际巨头存在明显差距。此外，EDA 工具还需要与国内半导体制造企业的需求紧密结合，以推动本土产业链的协同发展。

④高研发投入与市场准入门槛：EDA 行业需要持续的高研发投入，以保持技术领先和产品竞争力。国际巨头每年在研发上的投入占其收入的比重较高，这使得新进入者面临巨大的资金和时间成本。此外，市场准入门槛高，国际巨头凭借品牌效应和用户黏性，占据了大部分市场份额。国内企业需要在技术创新和市场拓展上双管齐下，才能打破国际垄断。

⑤智能化与云化趋势门槛：随着人工智能、大数据和云计算技术的快速发展，EDA 行业也在向智能化和云化方向演进。例如，AI 辅助设计可以显著提升设计效率和质量，而云平台则可以降低设计企业的硬件成本。然而，国内企业在智能化和云化技术的应用上相对滞后，需要加快技术研发和市场布局。

## (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

由于 EDA 工具在集成电路行业中所起的关键作用，且 EDA 行业具有产品验证难、市场门槛高的特点，尤其对于国际知名客户，其对新企业、新产品的验证和认可门槛较高。因此，EDA 行业研发成果要转化为受到国际主流市场认可的产品，不仅需要持续大量的研发投入以形成在技术上达到先进水平的产品，还需要具备较强的品牌影响力、渠道能力、快速迭代能力等。衡量公司产品或服务市场地位、技术水平及特点的主要标准为国际市场和全球领先集成电路企业认可和量产采用情况。

公司较早地进行了 DTCO 方法学探索和实践，聚焦于 EDA 流程创新，择其关键环节进行逐个突破，先后成功拥有了具有国际市场竞争力的器件建模及验证 EDA 工具和电路仿真及验证 EDA 工具。公司器件建模及验证 EDA 工具已经取得较高市场地位，被全球大部分领先的晶圆厂所采用和验证，主要客户包括台积电、三星电子、联电、格芯、中芯国际等全球前十大晶圆厂；电路仿真和验证 EDA 工具已经进入全球领先集成电路企业，主要客户包括三星电子、SK 海力士、美光等，具备在关键细分领域国际领先的市场地位。

公司主要客户遍及全球领先的晶圆代工厂、存储器厂商和国内外知名集成电路企业。公司主要产品和服务在上述企业设计和制造的过程中使用，其设计或制造出的集成电路产品被广泛应用于数据处理、汽车电子、消费电子、物联网、工业、计算机及周边等产业中，实现科技成果与广泛下游终端应用的深度融合。公司对国内 EDA 的发展有独到的认识和超前的战略规划，拥有具备

国际市场竞争力的领先核心技术，具备一个高科技硬核企业发展的所有关键要素，市场地位将持续显著提升。

### (3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2024 年，全球 EDA 行业在新技术、新产业、新业态和新模式等方面呈现出显著的发展趋势，为行业的未来走向奠定了基础。

首先，在新技术方面，AI 与 EDA 工具的融合成为重要趋势。AI 技术被广泛应用于设计优化、错误检测和验证环节，能够显著提升设计效率并减少人工干预，通过 AI 驱动的设计辅助工具，客户能够快速识别潜在问题，优化设计流程，缩短研发周期。此外，随着云计算的快速发展，EDA 工具逐渐向云平台迁移，降低了硬件成本，提高了设计效率。同时，量子计算和基于新材料（如石墨烯、碳纳米管）的电子元件正在逐步走向应用，这将推动 EDA 工具的更新和进步。

其次，在新产业方面，EDA 行业正加速向系统设计转型。随着半导体技术的飞速发展，芯片设计的复杂度呈指数级增长，传统 EDA 工具已难以满足市场需求。系统设计成为 EDA 企业的必由之路，通过整合多领域技术与资源，打造一站式解决方案，更好地服务客户。例如，2024 年初新思科技重磅宣布收购 Ansys，以期待通过此次并购强化系统设计能力，进一步巩固了其在 EDA 行业的领先地位。

在新业态和新模式方面，EDA 行业呈现出全球化和市场整合的趋势。EDA 企业通过战略收购加速业务转型。例如，铿腾电子通过收购 BETA CAE Systems 等企业，拓展了多物理场系统分析能力，构建了全方位的解决方案体系。西门子 EDA 则通过收购 Altair，深化了系统级 EDA 能力，进一步拓展了在航空航天、汽车等领域的应用。另一方面，市场竞争推动了行业进一步整合，中小企业可能通过并购抱团取暖，或深耕细分领域寻求差异化突破。此外，开源 EDA 工具的兴起为行业带来了新的机遇，EDA 企业可以通过积极参与开源生态建设，推动行业技术的普惠化。

展望未来，EDA 行业将继续朝着工具功能扩展、技术创新、市场全球化以及国产企业崛起等方向发展。随着 AI、5G、物联网、汽车电子等新兴技术的推动，EDA 工具将不断适应新的设计需求，提升性能和效率。同时，国产 EDA 企业有望在全球市场中占据更大份额，为全球半导体产业的发展提供更有力的支撑。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|                                 | 2024年            | 2023年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2022年            |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产                             | 2,465,703,479.40 | 2,518,818,229.77 | -2.11          | 2,500,976,632.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产                   | 1,951,619,806.64 | 2,094,705,214.65 | -6.83          | 2,150,226,195.55 |
| 营业收入                            | 419,080,178.55   | 328,896,154.28   | 27.42          | 278,549,701.39   |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 417,131,879.18   | 327,711,855.84   | 27.29          | 277,038,634.37   |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | -95,970,755.94   | -56,315,589.64   | 不适用            | 44,886,067.47    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润          | -89,486,714.30   | -66,655,612.27   | 不适用            | 32,075,475.12    |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | -46,515,613.62   | 51,030,263.22    | -191.15        | 70,315,054.31    |
| 加权平均净资产收益率(%)                   | -4.78            | -2.65            | 减少2.13个百分点     | 2.11             |
| 基本每股收益(元/股)                     | -0.22            | -0.13            | 不适用            | 0.10             |
| 稀释每股收益(元/股)                     | -0.22            | -0.13            | 不适用            | 0.10             |
| 研发投入占营业收入的比例(%)                 | 68.90            | 72.05            | 减少3.15个百分点     | 50.21            |

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 81,812,580.71    | 114,230,197.52   | 83,096,903.48    | 139,940,496.84     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -36,471,708.61   | -4,412,011.05    | -16,280,950.31   | -38,806,085.97     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -15,374,147.04   | -3,590,533.92    | -24,406,666.99   | -46,115,366.35     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -53,262,841.06   | 667,751.62       | -15,215,349.87   | 21,294,825.69      |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

#### 4、股东情况

##### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数(户)              |            |            |           | 12,401              |                |    |          |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|----------------|----|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)       |            |            |           | 11,350              |                |    |          |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）        |            |            |           | 0                   |                |    |          |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）  |            |            |           | 0                   |                |    |          |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）       |            |            |           | 0                   |                |    |          |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户） |            |            |           | 0                   |                |    |          |
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）        |            |            |           |                     |                |    |          |
| 股东名称<br>（全称）                  | 报告期内<br>增减 | 期末持股<br>数量 | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押、标记或<br>冻结情况 |    | 股东<br>性质 |
|                               |            |            |           |                     | 股份<br>状态       | 数量 |          |
| KLProTechH.K.Limited          | 0          | 91,637,109 | 21.12     | 91,637,109          | 无              | 0  | 境外法人     |
| 刘志宏                           | 0          | 70,055,723 | 16.15     | 70,055,723          | 无              | 0  | 境内自然人    |
| 共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）             | 0          | 30,846,366 | 7.11      | 30,846,366          | 无              | 0  | 其他       |
| 共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）         | -3,042,826 | 25,405,813 | 5.86      | 0                   | 无              | 0  | 其他       |
| 共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）             | 0          | 24,211,288 | 5.58      | 24,211,288          | 无              | 0  | 其他       |
| 共青城伟伦投资合伙企业（有限合伙）             | 0          | 21,667,044 | 4.99      | 21,667,044          | 无              | 0  | 其他       |
| 共青城经伦投资合伙企业（有限合伙）             | 0          | 10,189,103 | 2.35      | 10,189,103          | 无              | 0  | 其他       |
| 共青城博达投资合伙企业（有限合伙）             | -2,455,988 | 9,044,537  | 2.08      | 0                   | 无              | 0  | 其他       |
| 共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙）           | -1,224,330 | 7,895,794  | 1.82      | 0                   | 无              | 0  | 其他       |
| 井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙）           | -436,965   | 6,963,035  | 1.61      | 0                   | 无              | 0  | 其他       |

|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 上述股东中，公司股东刘志宏先生于 2024 年 12 月 29 日分别与共青城峰伦、KLProTech 签署了《一致行动解除协议》，以解除此前各方签署的一致行动协议；金秋投资、嘉橙投资、井冈山静远及共青城睿橙均为由公司董事陈晓飞实际控制的主体。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用                                                                                                                        |

**存托凭证持有人情况**

☐适用 ☒不适用

**截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

☐适用 ☒不适用

**4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

☐适用 ☒不适用

**4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

☐适用 ☒不适用

**4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况**

☐适用 ☒不适用

**5、公司债券情况**

☐适用 ☒不适用

**第三节 重要事项**

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司 2024 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ☒不适用